

上海韦尔半导体股份有限公司

截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到位情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2017年4月7日证监发行字[2017]469号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》，上海韦尔半导体股份有限公司首次向社会公众发行人民币普通股4,160.00万股，每股发行价格为人民币7.02元，股款以人民币缴足，计人民币292,032,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币50,685,000.00元后，净募集资金共计人民币241,347,000.00元，上述资金于2017年4月27日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2017]第ZA14314号验资报告。公司按照《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金的数额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2019年6月5日签发的证监许可[2019]1001号文《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司分别向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛融通民和投资中心（有限合伙）、Seagull Strategic Investments(A3), LLC、嘉兴水木豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴豪威股权投资合伙企业（有限合伙）、上海唐芯企业管理合伙企业（有限合伙）、Seagull Investments, LLC、开元朱雀（深圳）股权投资合伙企业

(有限合伙)、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙)、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)、北京天元滨海股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳惠盈一号投资合伙企业(有限合伙)、马鞍山领智基石股权投资合伙企业(有限合伙)、北京金信华创股权投资中心(有限合伙)、南通金信华通股权投资中心(有限合伙)、西藏大数和泰实业有限公司、上海威熠企业管理咨询咨询有限公司、西藏锦祥投资有限公司、上海摩勤智能技术有限公司、Seagull Strategic Investments(A1)、LLC、Seagull Equity Investments (C1-Int'l)(HongKong) Limited、Seagull Equity Investments (C1), LLC、深圳德威资本投资管理有限公司、深圳市远卓财富投资企业(有限合伙)、深圳市兴平股权投资管理企业(有限合伙)发行共 38,644.2308 万股股份购买北京豪威科技有限公司(以下简称“北京豪威”)85.53%股权;向北京博融思比科科技有限公司、南昌南芯集成电路产业投资中心(有限合伙)、山西 TCL 汇融创业投资有限公司、北京华清博广创业投资有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、吴南健、陈杰、刘志碧发行共 695.2394 万股股份购买北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“思比科”)42.27%股权;向陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健发行共 755.6745 万股股份购买北京视信源科技发展有限公司(以下简称“视信源”)79.93%股权。本次新发行股份的每股面值为人民币 1 元,每股发行价格为人民币 33.70 元。

公司本次交易的评估基准日为 2018 年 7 月 31 日,根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2018)第 40136 号《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京豪威科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,北京豪威在评估基准日归属于母公司所有者权益的评估值为人民币 1,413,100.00 万元,交易各方参照评估价值并经协商,标的资产交易价格确定为人民币 1,302,310.62 万元,公司发行 38,644.2308 万股份作为对价;根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字(2018)第 40074 号《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京思比科微电子技术股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,思比科在评估基准日归属于母公司所有者权益的评估值为人民币 54,600.00 万元,交易各方参照评估价值并经协商,标的资产交易价格确定为人民币 23,429.58 万元,

公司发行 695.2394 万股股份作为对价；根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评报字（2018）第 40136-31 号《上海韦尔半导体股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的北京视信源科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，视信源在评估基准日归属于母公司所有者权益的评估值为人民币 29,243.76 万元，交易各方参照评估价值并经协商，标的资产交易价格确定为人民币 25,466.25 万元，公司发行 755.6745 万股股份作为对价。根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 30 日核发的《营业执照》，北京豪威 85.53%的股权已过户至公司名下；根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 22 日出具的《备案通知书》，思比科已就股东名册等的变更涉及的公司章程的修改办理完毕工商备案手续；根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 30 日核发的《营业执照》，视信源 79.93%的股权已过户至韦尔股份名下。上述发行股份购买资产业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15325 号验资报告。

根据《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 200,000.00 万元。本次募集配套资金以非公开发行方式向富国基金管理有限公司、国元国际控股有限公司、博时基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和南方基金管理股份有限公司共计五位特定投资者发行人民币普通股（A 股）700.6711 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 57.68 元，共计募集资金总额为人民币 404,147,090.48 元，扣除承销费用、发行登记费以及其他交易费用人民币 37,291,138.43 元后，实际募集资金净额为人民币 366,855,952.05 元。上述资金于 2019 年 8 月 20 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2019]第 ZA15427 号验资报告。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	上海韦尔半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江支行	97160155200002608	70,996,797.55	80.16	
2	上海韦尔半导体股份有限公司	上海农商银行张江科技支行	50131000602125774	42,569,262.02	49,740.62	
3	上海韦尔半导体股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行	699641879	70,283,788.46	354.55	
4	上海韦尔半导体股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	316191-03003216418	57,497,151.97	135,062.06	
5	上海韦功微电子有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801100000182			
6	武汉泰合志恒科技有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127910638010801			
7	北京泰合志远科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行	731903890610701			注1
8	北京泰合志恒科技有限公司	招商银行股份有限公司北京分行世纪城支行	110908461610602			注2
合计	/	/	/	241,347,000.00	185,237.39	/

注：上海韦功微电子有限公司为本公司“射频元器件研发及产业化项目”实施主体，武汉泰合志恒科技有限公司、北京泰合志远科技有限公司、北京泰合志恒科技有限公司为本公司“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”实施主体。

注1：公司在2018年度将“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”的原实施主体北京泰合志远科技有限公司及武汉泰合志恒科技有限公司，变更为北京泰合志恒科技有限公司及武汉泰合志恒科技有限公司，为方便账户管理，公司对北京泰合志远科技有限公司募集资金专项账户进行销户。

注2：公司在2019年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。为方便账户管理，公司对北京泰合志恒科技有限公司募集资金专项账户进行销户。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	开户主体	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
1	上海韦尔半导体股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801200001369	377,647,090.48	25,660,962.60	
2	豪威半导体（上海）有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801600001375			未启用
3	豪威半导体（上海）有限责任公司	兴业银行股份有限公司上海嘉定支行	216130100100229664		300,125,207.94	
合计	/	/	/	377,647,090.48	325,786,170.54	/

注：豪威半导体（上海）有限责任公司为本公司“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”、“硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期）”项目实施主体。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际使用 2017 年首次公开发行募集资金 19,880.34 万元，具体情况详见附表 1《2017 年首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际使用 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金 1,359,070.09 万元，具体情况详见附表 2《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表》。

（二）前次募集项目实施主体变更情况

1、2017 年首次公开发行股票募集项目实施主体变更情况

2017 年 6 月 15 日公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为子公司的议案》。公司将募集资金投资项目之“射频元器件研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为公司控股子公司上海韦功微电子有限公司，同意公司将募集资金投资项目之“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体，由公司变更为公司全资子公司北京泰合志远科技有限公司及公司全资子公司武汉泰合志恒科技有限公司共同实施。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体变更的核查意见》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体。上述部分募投项目实施主体变更没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容不发生变化。

2018 年 7 月 2 日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》。公司将募集资金投资项目之“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体，由公司全资子公司北京泰合志远科技有限公司及公司全资子公司武汉泰合志恒科技有限公司变更为北京泰合志恒科技有限公司及武汉泰合志恒科技有限公司共同实施。除此之外，与“卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。保荐机构国信证券股份有限公司出具了

《关于上海韦尔半导体股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体变更的核查意见》，同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实施主体变更情况

截至2019年12月31日止，本公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目未发生前次募集资金实施主体变更的情况。

(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2019年12月31日止，本公司未发生前次募集资金投资项目变更的情况。

(四) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1、2017年首次公开发行股票募集项目

截至2019年12月31日止，公司2017年首次公开发行股票募集项目的实际投资总额为人民币19,880.34万元，调整后承诺投资总额为人民币19,834.22万元（以2019年度调整后的募集资金承诺投资总额为依据），实际投资总额超过承诺的差额为人民币46.12万元。差异系收到募集资金利息用于项目投入。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目

截至2019年12月31日止，公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目投资总额与承诺不存在差异。

(五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2017年首次公开发行股票募集项目对外转让或置换情况

2017年6月15日第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金5,925.27万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA15439号《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

2017年10月31日第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,178.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZA16217号《关于上海韦尔半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截至2019年12月31日止，公司2017年首次公开发行股票募集项目置换累计金额为8,103.55万元。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目对外转让或置换情况

2019年9月27日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,866.16万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZA15616号《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金置换专项审核报告》；独立财务顾问国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

截至2019年12月31日止，公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目置换累计金额为3,866.16万元。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、使用闲置2017年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2017年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月15日公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过人民币10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。保荐机构国信证券股份有限公司出具了

《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于 2017 年 6 月 19 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 3,500 万元，2017 年 6 月 20 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 6,500 万元。截至 2017 年 12 月 22 日止，公司已将用于补充流动资金的人民币 10,000 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

（2）2018 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 7 月 3 日公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，总金额不超过 5,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司于 2018 年 7 月 4 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 500 万元，2018 年 7 月 10 日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 4,000 万元。截至 2019 年 7 月 2 日止，公司已将用于补充流动资金的人民币 4,500 万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司不存在用于暂时补充流动资金尚未归还的募集资金。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在对前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、2017 年首次公开发行股票募集资金项目节余募集资金使用情况

2019 年 11 月 22 日公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会

议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、监事会均发表了明确同意意见。2019年第二次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将募投项目结项后的节余募集资金 4,413.10 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于上海韦尔半导体股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》。

根据上述决议，公司在 2019 年度实施了募集项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金工作。

截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集账户余额中尚未转出的节余募集资金为 135,062.06 元，转出后尚未完成销户的账户银行结息 50,175.33 元。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目尚在投资建设阶段，不存在节余募集资金使用的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司 2017 年首次公开发行募集项目累计实现效益 3,836.71 万元，具体情况详见附表 3《2017 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目累计实现效益 110,616.16 万元，具体情况详见附表 4《2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“支付中介机构费用”项目募集资金全部用于支付发行股份购买资产并募集配套资金相关中介机构费用，不适用单独核算实现效益情况。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目的累计实现收益基本与承诺累计收益一致。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

（一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目资产权属变更情况

根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 30 日核发的《营业执照》，北京豪威 85.53%的股权已过户至公司名下；根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 22 日出具的《备案通知书》，思比科已就股东名册等的变更涉及的公司章程的修改办理完毕工商备案手续；根据北京市海淀区市场监督管理局于 2019 年 7 月 30 日核发的《营业执照》，视信源 79.93%的股权已过户至韦尔股份名下。

（二）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目资产账面价值变化情况

1、北京豪威科技有限公司（金额单位：人民币万元）

项目	最近一期经审计基准日 截至 2019 年 12 月 31 日止	资产购入的审计、评估基准日 截至 2018 年 7 月 31 日止
资产总额	1,740,383.27	1,410,695.47
负债总额	605,478.08	453,508.64
净资产	1,134,905.19	957,186.83

2、北京思比科微电子技术股份有限公司（金额单位：人民币万元）

项目	最近一期经审计基准日 截至 2019 年 12 月 31 日止	资产购入的审计、评估基准日截 至 2018 年 7 月 31 日止
资产总额	27,068.67	27,170.75
负债总额	11,601.29	19,859.17
净资产	15,467.38	7,311.58

3、北京视信源科技发展有限公司（金额单位：人民币万元）

项目	最近一期经审计基准日 截至 2019 年 12 月 31 日止	资产购入的审计、评估基准日截 至 2018 年 7 月 31 日止
资产总额	27,076.44	27,182.79
负债总额	11,789.14	20,030.98
净资产	15,287.30	7,151.81

（三）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目生产经营情况和效益贡献情况

按照北京豪威除虞仁荣、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）外业绩承诺方的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 54,541.50 万元、84,541.50 万元、112,634.60 万元；按照虞仁荣、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 59,938.87 万元、88,481.57 万元、115,146.55 万元。北京豪威 2019 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 104,071.07 万元，超额完成盈利预测以及承诺事项，故承诺方无需进行业绩补偿。

按照思比科业绩承诺方的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,500.00 万元、4,500.00 万元、6,500.00 万元。思比科 2019 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 4,263.57 万元，超额完成盈利预测以及承诺事项，故承诺方无需进行业绩补偿。

按照视信源业绩承诺方的业绩承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 1,346.00 万元、2,423.00 万元、3,500.00 万元。视信源 2019 年度扣除非经常性损益后净利润实现数为 2,281.52 万元，超额完成盈利预测以及承诺事项，故承诺方无需进行业绩补偿。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1:

2017 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海韦尔半导体股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额:			24,134.70			已累计使用募集资金总额:			19,880.34	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:						2017 年:			8,272.18	
						2018 年:			6,853.62	
						2019 年:			4,754.54	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					项目达到 预定可使用 状态日期 (或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额 (1)	实际投资 金额 (2)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 (3)=(2)-(1)	
1	高性能分立器件研发升级项目	高性能分立器件研发升级项目	7,028.38	7,028.38	7,044.46	7,028.38	7,028.38	7,044.46	16.08	2019 年 5 月
2	IC 系列的升级研发项目	IC 系列的升级研发项目	5,749.72	5,749.72	5,779.76	5,749.72	5,749.72	5,779.76	30.04	2019 年 5 月
3	射频元器件研发及产业化项目	射频元器件研发及产业化项目	4,256.93	2,370.54	2,370.54	4,256.93	2,370.54	2,370.54	0.00	2019 年 11 月
4	卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目	卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目	7,099.67	4,685.58	4,685.58	7,099.67	4,685.58	4,685.58	0.00	2019 年 11 月
合计	/	/	24,134.70	19,834.22	19,880.34	24,134.70	19,834.22	19,880.34	46.12	/

注 1: 高性能分立器件研发升级项目旨在完善高性能分立器件的产品系列化, 以实现公司分立器件产品系列化程度最高、器件种类最齐全, 提升对客户的多产品服务能力, 计划投入募集资金金额为 7,028.38 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止, 实际募集资金投资金额为 7,044.46 万元 (含利息收入 16.08 万元), 项目资金投入进度 100.23%, 项目已结项。

注 2: IC 系列的升级研发项目旨在通过本项目的建设,公司电源管理芯片系列产品将得到极大丰富、性能得到进一步提高、应用领域得到进一步拓展,进而巩固公司在电源管理芯片领域的竞争优势,全面提升公司品牌价值和市场地位,计划投入募集资金金额为 5,749.72 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,实际募集资金投资金额为 5,779.76 万元(含利息收入 30.04 万元),项目资金投入进度 100.52%,项目已结项。

注 3: 射频元器件研发及产业化项目包含射频芯片研发项目和 BLE 芯片研发项目两个子项目。通过本项目的建设,公司拟开拓新的产品线,拓宽公司的产品研发及设计能力,计划投入募集资金金额为 2,370.54 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,实际募集资金投资金额为 2,370.54 万元,项目资金投入进度 100.00%,项目已结项。原计划 2019 年 5 月可达到预定可使用状态,由于 BLE 产品市场竞争较为激烈,实现技术突破所需资金及技术投入较大,公司在综合考虑市场及技术等原因后,现阶段不再进行流片及资金投入,未来将视市场情况以自有资金进行投入。

注 4: 卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目包含 40nm 高级安全直播星高清解码芯片研发及产业化项目和多模地面数字电视接收芯片研发及产业化项目两个子项目,计划投入募集资金金额为 4,685.58 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止,实际募集资金投资金额为 4,685.58 万元,项目资金投入进度 100.00%,项目已结项。原计划 2019 年 5 月可达到预定可使用状态,由于政策调整、四代机头端环境搭建调试、终端产品的入网认证测试标准建立等客观原因,导致整体项目投资进度放缓。近年来市场也发生较大变化,公司本着降低投资风险的角度,现阶段不再进行流片及资金投入,未来将视市场情况以自有资金进行投入。

附表 2:

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

编制单位: 上海韦尔半导体股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额:			1,391,621.16			已累计使用募集资金总额:			1,359,070.09	
变更用途的募集资金总额:			/			各年度使用募集资金总额:			0.00	
变更用途的募集资金总额比例:			/			2017 年:			0.00	
						2018 年:			0.00	
						2019 年:			1,359,070.09	
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 (或截止日项 目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额 (1)	实际投资 金额 (2)		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 (3)=(2)-(1)
1	发行股份购买北京豪威 85.53% 股权	发行股份购买北京豪威 85.53% 股权	1,302,310.62	1,302,310.62	1,302,310.62	1,302,310.62	1,302,310.62	1,302,310.62		不适用
2	发行股份购买思比科 42.27% 股权	发行股份购买思比科 42.27% 股权	23,429.58	23,429.58	23,429.58	23,429.58	23,429.58	23,429.58		不适用
3	发行股份购买视信源 79.93% 股权	发行股份购买视信源 79.93% 股权	25,466.25	25,466.25	25,466.25	25,466.25	25,466.25	25,466.25		不适用
4	晶圆测试及晶圆重构生产线项目 (二期) (注 1)	晶圆测试及晶圆重构生产线项目 (二期)	32,551.55	32,551.55	0.48	32,551.55	32,551.55	0.48	-32,551.07	2022 年 5 月
5	硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目 (二期) (注 2)	硅基液晶高清投影显示芯片生产线 项目 (二期)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	支付中介机构费用	支付中介机构费用	7,863.16	7,863.16	7,863.16	7,863.16	7,863.16	7,863.16	0.00	不适用
合计	/	/	1,391,621.16	1,391,621.16	1,359,070.09	1,391,621.16	1,391,621.16	1,359,070.09	-32,551.07	/

注 1：晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）项目主要针对高像素图像显示芯片的 12 寸晶圆测试及重构封装，高像素图像显示芯片广泛应用于智能手机、安防、汽车、多媒体应用等领域。计划投入募集资金金额为 32,551.55 万元。截至 2019 年 12 月 31 日止，实际募集资金投资金额为 0.48 万元。

注 2：根据 2019 年非公开发行募集资金结果，拟不使用本次募集所得资金对硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期）进行投入，未来将视市场情况进行投入。

附表 3:

2017 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海韦尔半导体股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	高性能分立器件研发升级项目	已达产	运营期首年净利润-2,250.96 万元, 运营期年均净利润 2,470.76 万元	424.91	1,969.21	4,447.19	4,908.98	是
2	IC 系列的升级研发项目	已达产	运营期首年净利润-3,489.69 万元, 运营期年均净利润 3,117.55 万元	585.12	1,705.08	3,327.67	2,946.27	是
3	射频元器件研发及产业化项目	不适用	运营期首年净利润-2,172.96 万元, 运营期年均净利润 1,862.04 万元	-170.26	-217.43	-88.66	-476.35	注 1
4	卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目	不适用	运营期首年净利润-2,312.58 万元, 运营期年均净利润 1,372.47 万元	-670.73	-845.66	-1202.69	-3,542.19	注 2
合计	/	/	/	169.04	2,611.20	6,483.51	3,836.71	/

注: 累计实现效益自项目成立初始投入日期起计算。

注 1: 射频元器件研发及产业化项目由于 BLE 产品市场竞争较为激烈, 实现技术突破所需资金及技术投入较大, 公司在综合考虑市场及技术等原因后, 现阶段不再进行流片及资金投入, 未来将视市场情况以自有资金进行投入。

注 2: 卫星直播、地面无线接收芯片研发及产业化项目由于政策调整、四代机头端环境搭建调试、终端产品的入网认证测试标准建立等客观原因, 导致整体项目投资进度放缓。近年来市场也发生较大变化, 公司本着降低投资风险的角度, 现阶段不再进行流片及资金投入, 未来将视市场情况以自有资金进行投入。

附表 4:

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 上海韦尔半导体股份有限公司

截至 2019 年 12 月 31 日止

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	发行股份购买北京豪威 85.53% 股权	不适用	北京豪威除虞仁荣、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）外业绩承诺方承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 54,541.50 万元、84,541.50 万元、112,634.60 万元；虞仁荣、绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺，2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 59,938.87 万元、88,481.57 万元、115,146.55 万元。	不适用	不适用	104,071.07	104,071.07	是
2	发行股份购买思比科 42.27% 股权	不适用	思比科业绩承诺方承诺 2019 年度、2020 年度、2021 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 2,500.00 万元、4,500.00 万元、6,500.00 万元	不适用	不适用	4,263.57	4,263.57	是

3	发行股份购买视信源79.93%股权	不适用	视信源业绩承诺方承诺2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于1,346.00万元、2,423.00万元、3,500.00万元	不适用	不适用	2,281.52	2,281.52	是
4	晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）	不适用	运营期年均净利润18,642.44万元	不适用	不适用	不适用	无	注1
5	硅基液晶高清投影显示芯片生产线项目（二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	支付中介机构费用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注2
合计	/	/	/	/	/	110,616.16	110,616.16	/

注1：“晶圆测试及晶圆重构生产线项目（二期）”项目尚在投资建设阶段，暂未实现相关效益。

注2：截至2019年12月31日止，本公司2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目中“支付中介机构费用”项目募集资金全部用于支付发行股份购买资产并募集配套资金相关中介机构费用，不适用单独核算实现效益情况。